

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
APB3227SURKZGC	Hyper Red (AlGaInP)	Water Clear	120	250	100°
			*40	*80	
	Green (InGaN)		200	400	
			*200	*400	

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.
- * Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	Hyper Red Green	645 515		nm	I _F =20mA
λD [1]	Dominant Wavelength	Hyper Red Green	630 525		nm	I _F =20mA
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	Hyper Red Green	28 30		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Hyper Red Green	35 45		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F [2]	Forward Voltage	Hyper Red Green	1.95 3.3	2.5 4.1	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	Hyper Red Green		10 50	μA	V _R = 5V

Notes:

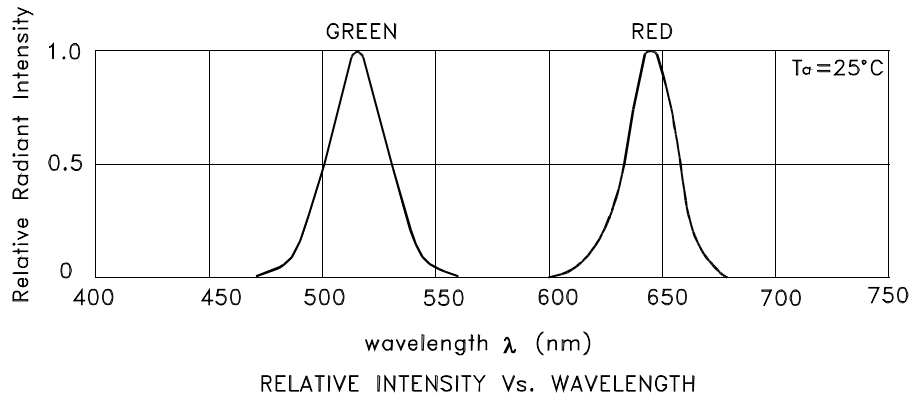
1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.
3. Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

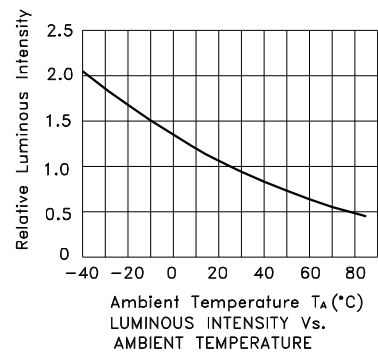
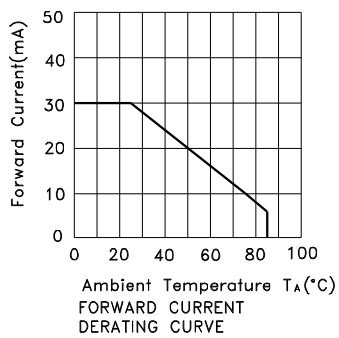
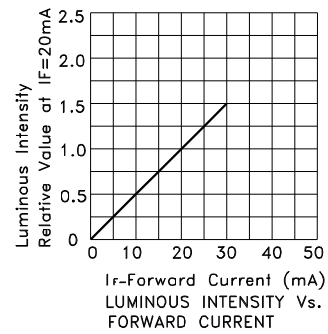
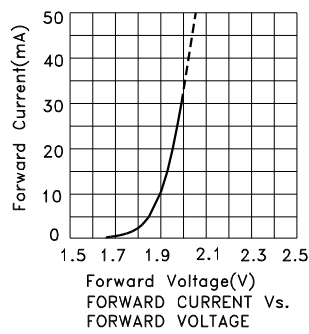
Parameter	Hyper Red	Green	Units
Power dissipation	75	102.5	mW
DC Forward Current	30	25	mA
Peak Forward Current [1]	185	150	mA
Reverse Voltage	5		V
Operating Temperature	-40°C To +85°C		
Storage Temperature	-40°C To +85°C		

Note:

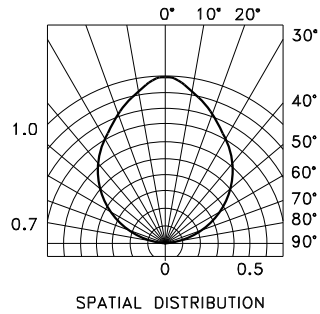
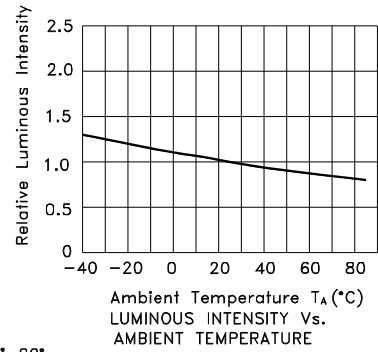
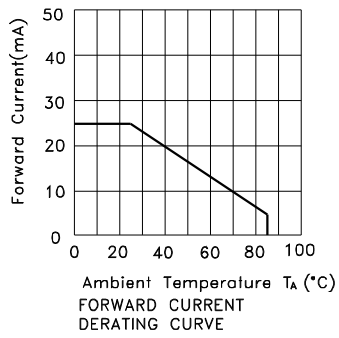
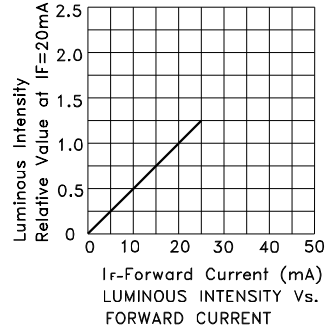
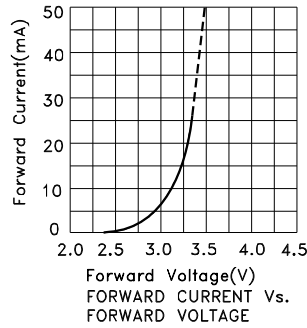
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.



APB3227SURKZGC Hyper Red



Green



APB3227SURKZGC

Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.

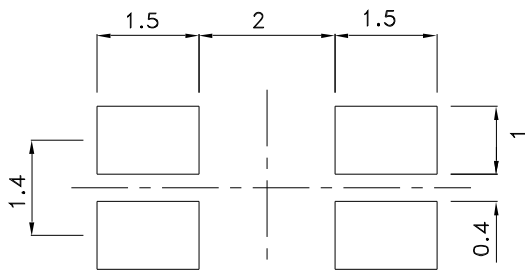
Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.



NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

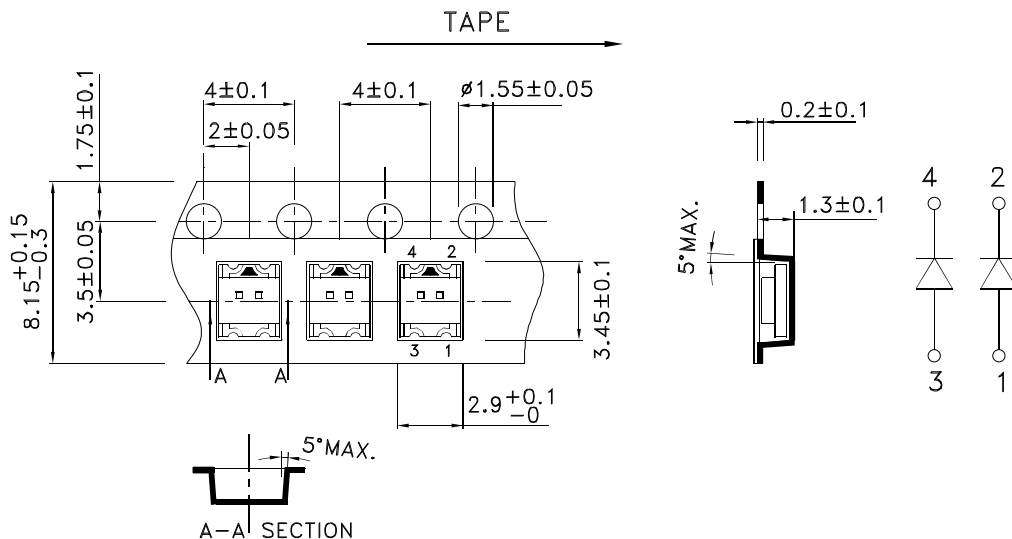
Recommended Soldering Pattern (Units : mm; Tolerance: ± 0.1)



Reel Dimension



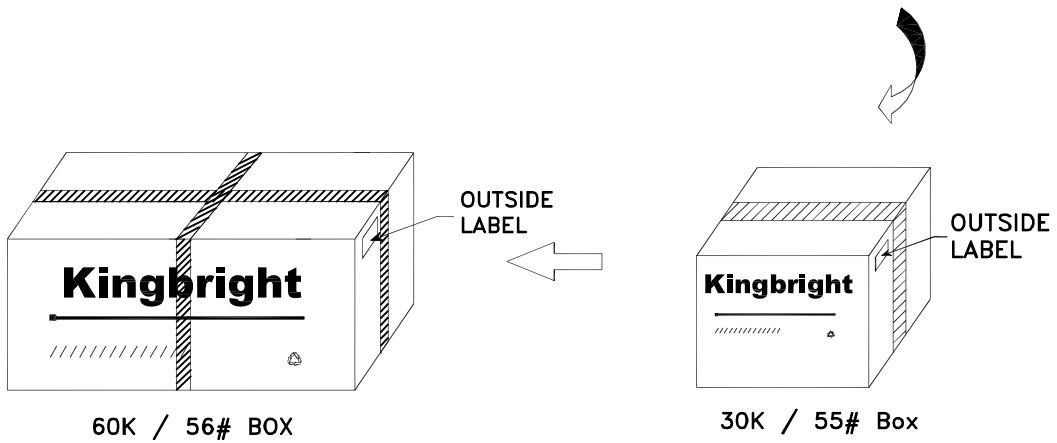
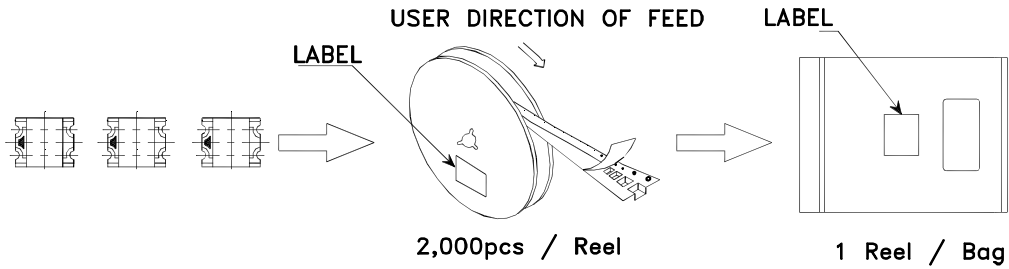
Tape Dimensions (Units : mm)




Kingbright

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APB3227SURKZGC



<h1>Kingbright</h1>	
P/NO: APB3227XXX	
QTY: 2,000 pcs	Q.C. Q C XX XX XXXX PASSED
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
	
RoHS Compliant	

All design applications should refer to Kingbright application notes available at <http://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9